



## LOTPASTE SC BLF 082

Typ ISO 1.2.3.C

Die Lotpaste **SOLDER CHEMISTRY BLF082** ist die neueste Weiterentwicklung im Hinblick auf alle sogenannten **bleifreien SMT-Anwendungen** und dem Kundenwunsch nach einer leichter druckbaren und sehr lange klebenden Paste, um die teils **tagelangen Stillzeiten** zwischen Drucken und Bestücken überbrücken zu können. Dabei soll unserer „Markenzeichen“ d.h. minimalste Rückstände auf der PCB, die dicht an der Lötstelle nach dem Löten verbleiben, behalten werden. Die Verwendung von neusten Typen von modifizierten Kunststoffen und Rheologiezusätzen bei der Lotpaste und die daraus resultierende, sehr gute Kombinationsmöglichkeit mit bleifreien Legierungen, sowie die neuesten Erkenntnisse in der SMT haben zu dieser Weiterentwicklung beigetragen. Eine sorgfältige und strenge Beachtung der Richtlinien von ISO-, EN-, IPC- und MIL-Normen lag auch ihr selbstverständlich zugrunde.

Die **BLF082** ist physikalisch gesehen eine gleichmäßige Mischung aus einem **bleifreien Lotpulver**, in allen erforderlichen Legierungen und Körnungen lieferbar, mit einem organischen Bindemittel auf **Kunstharzbasis**, das der Kl. RE L0 nach DIN EN61190-1-1 oder RMA-Qualifizierung entspricht.

Die üblichen Vorteile, wie die hervorragende Konturenstabilität, keine Lotkugel- oder Spritzerbildung, sowie hohe Temperaturstabilität, zeichnen diese Paste, neben einer langzeitigen Verarbeitbarkeit und exzellenter Standzeit, folgende Vorteile aus:

- \* **BLF082\* Exzellente Resistenz gegen Feuchtigkeit. Tagelange Klebrigkeit!!!**
- \* **BLF082\* Bildet sehr homogene, lunkerfreie Lötstellen!**
- \* **BLF082\* Lötet hervorragend, auch auf leicht korrodierten Oberflächen. (QFN-Form!)**
- \* **BLF082\* Die Rückstände sind absolut halogenfrei. (RE L0 Klassifizierung)**
- \* **BLF082\* Eine nochmals verbesserte Druckqualität, wie bereits gewohnt!**
- \* **BLF082\* Hinterlässt natürlich keine teerartigen Rückstände in der Lötanlage.**
- \* **BLF082\* Minimalste, kaum sichtbare Rückstände, bei so gut wie keinem Solderballing**

### PHYSIKALISCHE DATEN

| <u>Bevorzugte Legierungen</u> | <u>Schmelzpunkt</u> | Gemäß Internationalem Standard liefern wir diese Legierungen in den Klassen: |            |
|-------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Sn96,5/Ag3,5                  | 221°C               |                                                                              |            |
| Sn95,5/Ag3,8/Cu0,7            | 219°C               | Kl.3                                                                         | 25 – 45 µm |
| Sn96,9/Ag2,6/Cu0,5            | 217-221°C           | Kl.4                                                                         | 20 – 38 µm |
| <b>Sn96,5/Ag3/Cu0,5</b>       | 217-219°C           | Kl.5                                                                         | 10 – 25 µm |
| Sn99,3/Cu0,7                  | 227°C               |                                                                              |            |

**VISKOSITÄT** (Pa.S) ± 10% gemessen nach Brookfield RVT–DV II Viskosimeter mit 88% Metallgehalt:

| <u>Viskosität:*</u> |                  | <u>Konturenstabilität – DIN 32513</u> |                   | <u>Solderballing</u> | <u>Benetzung</u> |
|---------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|
|                     |                  | <u>Sofort</u>                         | <u>20min 80°C</u> | <u>nach IPC</u>      | <u>nach IPC</u>  |
| 900 Pa*s            | Pulverklasse III | Kl.1 = 0,2                            | 0,2               |                      |                  |
| 950 Pa*s            | Pulverklasse IV  | Kl.2 = 0,2                            | 0,3               | 1                    | 1                |

